【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成18年3月30日(2006.3.30)

【公表番号】特表2005-521250(P2005-521250A)
【公表日】平成17年7月14日(2005.7.14)
【年通号数】公開・登録公報2005-027
【出願番号】特願2003-578613(P2003-578613)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/3065　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　 4/10　 (2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/205　 (2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/302　１０１Ｇ
Ｃ２３Ｃ　 4/10
Ｈ０１Ｌ　21/205

【手続補正書】
【提出日】平成18年2月13日(2006.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
少なくともセラミック材料を含む部品を有する半導体処理装置の構成部品であって、
前記部品は、前記構成部品の最表面を含み、
前記セラミック材料は、そのセラミック材料のうち最も大きい成分として、ハフニウム窒化物、ハフニウムホウ化物、ハフニウムカーバイド、ハフニウムフッ化物、ストロンチウム酸化物、ストロンチウム窒化物、ストロンチウムホウ化物、ストロンチウムカーバイド、ストロンチウムフッ化物、ランタン酸化物、ランタン窒化物、ランタンホウ化物、ランタンカーバイド、ランタンフッ化物、ジスプロシウム酸化物、ジスプロシウム窒化物、ジスプロシウムホウ化物、ジスプロシウムカーバイド及びジスプロシウムフッ化物で構成されるグループから選択される材料を含むことを特徴とする構成部品。